

株式会社ヨコオとの戦略的業務資本提携に関するお知らせ

当社は、この度、株式会社ヨコオ（以下、ヨコオ）との間で、戦略的業務資本提携を行うこととしましたので、以下のとおりお知らせします。

1. 背景及び目的

当社は、さまざまな特殊ガラスの開発、製造、販売を行っており、電子デバイス用途においても、半導体及び情報通信分野を中心に多様なガラス製品を手掛けています。その中でも、LTCC技術を活用した製品開発及び事業拡大を進めており、ヨコオとは、共同出資(当社70%、ヨコオ30%)により設立したLTCCマテリアルズ株式会社を通じてLTCC事業を展開しています。

今般、両社のさらなる連携強化により、半導体及び情報通信分野を中心とした新製品・新技術の開発を加速することを目的として、業務資本提携を実施することとしました。本提携により、当社の多様な材料開発技術とヨコオの高度なデバイス開発技術を融合し、高付加価値製品の開発及び事業拡大を推進し、成長分野における競争力の一層の強化を図ってまいります。

2. 提携先

①社名	株式会社ヨコオ（証券コード：6800）
②本社所在地	東京都千代田区神田須田町 1-25
③代表者	代表取締役兼執行役員社長 柳澤勝平
④従業員数	連結 8,792 名（2026年3月末現在）
⑤資本金	78 億円（2026年3月末現在）

3. 提携内容（概要）

（1）業務提携

- ・ LTCC 基板やガラスインターポザーを用いた、半導体・光電融合デバイスに関する検査基板、評価用基板、検査治具等に使用される技術または製品の共同開発・商用化に関する事業
- ・ 5G 及び 6G 用のアンテナ・その技術に関する共同開発・商用化に関する事業
- ・ その他両社で合意した事業

(2) 資本提携

当社及びヨコオは、本業務提携を通じたより強固で長期的なパートナーシップの構築を目的に、本日までに5億円を上限として双方が相手方の株式を取得しています。

4. 時期

提携開始日 2026年4月1日

※LTCC：Low Temperature Co-fired Ceramics：低温同時焼成セラミックス。電気抵抗の低い銀または銅を導体として使用したセラミックス多層回路基板の一種。

※インターポーザー：複数の半導体チップ（チップレット）を接続するための中間基板。これを用いることで、チップ間の配線距離を短縮し、高密度な接続と高速データ伝送を可能にする。

以 上

日本電気硝子株式会社 〒520-8639 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号

《リリース内容に関するお問い合わせ》

コーポレートコミュニケーション部 IR担当 電話：077-537-1702（ダイヤルイン）